

電子回路基板生産動向(2008年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 20年 1月 実績	電子回路基板	2,001	82,324	103.0	103.4	2,001	82,324	103.0	103.4
	リジッドプリント配線板	1,286	50,935	101.2	103.9	1,286	50,935	101.2	103.9
	片面プリント配線板	196	1,110	89.5	96.1	196	1,110	89.5	96.1
	両面プリント配線板	574	11,930	97.0	105.6	574	11,930	97.0	105.6
	多層プリント配線板(4層)	247	9,007	105.6	98.4	247	9,007	105.6	98.4
	多層プリント配線板(6-8層)	118	12,076	109.3	103.0	118	12,076	109.3	103.0
	多層プリント配線板(10層以上)	25	4,272	92.6	90.1	25	4,272	92.6	90.1
	ビルドアップ多層配線板	126	12,540	137.0	114.5	126	12,540	137.0	114.5
	フレキシブルプリント配線板	422	10,945	105.5	102.8	422	10,945	105.5	102.8
	片面フレキシブル配線板	174	3,435	102.4	82.0	174	3,435	102.4	82.0
	両面・多層フレキシブル配線板	248	7,510	107.8	116.3	248	7,510	107.8	116.3
	モジュール基板	291	20,290	108.2	102.6	291	20,290	108.2	102.6
	リジッド系モジュール基板	59	13,492	120.4	107.0	59	13,492	120.4	107.0
その他のモジュール基板	232	6,798	105.5	94.8	232	6,798	105.5	94.8	
その他の電子回路基板	2	154	100.0	103.4	2	154	100.0	103.4	
平成 20年 2月 実績	電子回路基板	2,048	79,098	107.3	98.1	4,049	161,422	105.1	100.8
	リジッドプリント配線板	1,334	49,868	103.7	99.1	2,620	100,803	102.5	101.4
	片面プリント配線板	217	1,262	89.7	97.5	413	2,372	89.6	96.8
	両面プリント配線板	592	12,049	105.7	103.5	1,166	23,979	101.2	104.5
	多層プリント配線板(4層)	263	8,818	111.0	100.1	510	17,825	108.3	99.2
	多層プリント配線板(6-8層)	118	10,811	96.7	89.9	236	22,887	102.6	96.3
	多層プリント配線板(10層以上)	27	4,216	103.8	93.3	52	8,488	98.1	91.6
	ビルドアップ多層配線板	118	12,712	119.2	105.6	244	25,252	127.7	109.8
	フレキシブルプリント配線板	435	10,873	111.8	98.7	857	21,818	108.6	100.7
	片面フレキシブル配線板	191	3,465	101.6	83.1	365	6,900	102.0	82.5
	両面・多層フレキシブル配線板	244	7,408	121.4	108.3	492	14,918	114.2	112.2
	モジュール基板	278	18,232	120.3	95.5	569	38,522	113.8	99.1
	リジッド系モジュール基板	49	11,520	96.1	90.2	108	25,012	108.0	98.5
その他のモジュール基板	229	6,712	127.2	106.2	461	13,510	115.3	100.1	
その他の電子回路基板	1	125	50.0	81.2	3	279	75.0	92.1	
平成 20年 3月 実績	電子回路基板	2,056	81,121	99.0	90.7	6,105	242,543	103.0	97.1
	リジッドプリント配線板	1,324	51,621	96.9	93.8	3,944	152,424	100.5	98.7
	片面プリント配線板	214	1,239	89.2	95.0	627	3,611	89.4	96.2
	両面プリント配線板	586	12,328	96.4	92.1	1,752	36,307	99.5	100.0
	多層プリント配線板(4層)	250	8,959	100.8	89.8	760	26,784	105.7	95.9
	多層プリント配線板(6-8層)	113	10,988	85.6	83.4	349	33,875	96.4	91.7
	多層プリント配線板(10層以上)	29	4,593	111.5	99.6	81	13,081	102.5	94.3
	ビルドアップ多層配線板	133	13,514	118.8	107.2	377	38,766	124.4	108.9
	フレキシブルプリント配線板	431	10,563	96.2	84.5	1,288	32,381	104.1	94.8
	片面フレキシブル配線板	183	3,365	88.4	77.4	548	10,265	97.0	80.8
	両面・多層フレキシブル配線板	248	7,198	102.9	88.3	740	22,116	110.1	103.1
	モジュール基板	301	18,910	115.8	86.9	870	57,432	114.5	94.7
	リジッド系モジュール基板	55	12,056	101.9	81.2	163	37,068	105.8	92.1
その他のモジュール基板	245	6,854	118.9	99.4	706	20,364	116.5	99.9	
その他の電子回路基板	0	27	0.0	16.9	3	306	50.0	66.1	
平成 20年 4月 実績	電子回路基板	2,043	78,410	99.3	92.9	8,148	320,953	102.0	96.1
	リジッドプリント配線板	1,315	50,022	97.9	95.4	5,259	202,446	99.9	97.9
	片面プリント配線板	214	1,226	89.2	95.2	841	4,837	89.4	95.9
	両面プリント配線板	573	11,726	97.0	98.7	2,325	48,033	98.9	99.7
	多層プリント配線板(4層)	243	8,800	99.2	92.6	1,003	35,584	104.0	95.1
	多層プリント配線板(6-8層)	125	11,203	92.6	86.7	474	45,078	95.4	90.4
	多層プリント配線板(10層以上)	22	4,046	100.0	92.4	103	17,127	102.0	93.8
	ビルドアップ多層配線板	137	13,021	124.5	104.4	514	51,787	124.5	107.7
	フレキシブルプリント配線板	411	9,805	94.9	83.8	1,699	42,186	101.7	92.0
	片面フレキシブル配線板	160	2,777	81.6	68.1	708	13,042	93.0	77.7
	両面・多層フレキシブル配線板	251	7,028	106.4	92.3	991	29,144	109.1	100.3
	モジュール基板	318	18,564	113.6	92.2	1,188	75,996	114.2	94.1
	リジッド系モジュール基板	58	11,463	113.7	89.7	221	48,531	107.8	91.5
その他のモジュール基板	260	7,101	114.0	96.4	966	27,465	115.8	98.9	
その他の電子回路基板	0	19	0.0	12.6	3	325	37.5	52.9	

電子回路基板生産動向(2008年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 20年 5月 実績	電子回路基板	1,994	75,464	97.5	93.8	10,142	396,417	100.6	95.3
	リジッドプリント配線板	1,222	45,137	91.7	93.0	6,481	247,583	97.5	96.5
	片面プリント配線板	205	1,145	84.0	91.6	1,046	5,982	88.3	95.1
	両面プリント配線板	529	10,732	89.1	90.3	2,854	58,765	96.6	97.6
	多層プリント配線板(4層)	231	8,292	97.9	98.7	1,234	43,876	102.4	95.6
	多層プリント配線板(6-8層)	107	9,912	92.2	90.4	581	54,990	100.3	95.9
	多層プリント配線板(10層以上)	19	3,588	82.6	85.0	122	20,715	102.5	94.5
	ビルドアップ多層配線板	130	11,468	108.3	97.1	644	63,255	106.3	97.4
	フレキシブルプリント配線板	436	10,419	100.9	87.0	2,135	52,605	101.6	91.0
	片面フレキシブル配線板	164	2,851	88.2	70.8	872	15,893	92.1	76.4
	両面・多層フレキシブル配線板	273	7,568	111.4	95.2	1,264	36,712	109.6	99.2
	モジュール基板	336	19,878	120.0	100.2	1,524	95,874	115.4	95.3
	リジッド系モジュール基板	61	12,235	117.3	95.3	282	60,766	109.7	92.3
その他のモジュール基板	275	7,643	120.6	109.0	1,241	35,108	116.9	101.0	
その他の電子回路基板	0	30	0.0	22.6	3	355	33.3	47.5	
平成 20年 6月 実績	電子回路基板	2,105	79,653	97.5	98.6	12,247	476,070	100.1	95.9
	リジッドプリント配線板	1,300	49,636	91.4	97.5	7,781	297,219	96.4	96.7
	片面プリント配線板	220	1,239	82.7	89.2	1,266	7,221	87.3	94.0
	両面プリント配線板	545	11,273	86.4	88.9	3,399	70,038	94.8	96.1
	多層プリント配線板(4層)	226	7,848	93.0	93.6	1,460	51,724	100.8	95.3
	多層プリント配線板(6-8層)	127	11,369	105.8	110.6	708	66,359	101.3	98.1
	多層プリント配線板(10層以上)	32	4,164	110.3	81.1	154	24,879	104.1	92.0
	ビルドアップ多層配線板	150	13,743	112.8	105.4	794	76,998	107.4	98.8
	フレキシブルプリント配線板	441	10,836	101.6	90.0	2,576	63,441	101.6	90.8
	片面フレキシブル配線板	161	3,030	84.3	72.9	1,033	18,923	90.8	75.8
	両面・多層フレキシブル配線板	279	7,806	115.3	99.0	1,543	44,518	110.6	99.1
	モジュール基板	365	19,144	121.3	108.6	1,889	115,018	116.5	97.3
	リジッド系モジュール基板	61	11,983	132.6	117.1	343	72,749	113.2	95.6
その他のモジュール基板	304	7,161	118.8	96.9	1,545	42,269	117.2	100.3	
その他の電子回路基板	0	37	0.0	20.9	3	392	27.3	42.4	
平成 20年 7月 実績	電子回路基板	2,173	81,964	97.9	98.1	14,420	558,034	99.7	96.2
	リジッドプリント配線板	1,331	50,203	90.9	96.6	9,112	347,422	95.6	96.7
	片面プリント配線板	226	1,371	85.3	102.4	1,492	8,592	86.9	95.3
	両面プリント配線板	572	11,598	90.1	88.8	3,971	81,636	94.1	95.0
	多層プリント配線板(4層)	224	8,023	83.6	93.6	1,684	59,747	98.1	95.1
	多層プリント配線板(6-8層)	137	11,501	100.0	98.5	845	77,860	101.1	98.2
	多層プリント配線板(10層以上)	24	4,155	92.3	100.4	178	29,034	102.3	93.1
	ビルドアップ多層配線板	148	13,555	110.4	102.9	942	90,553	107.9	99.4
	フレキシブルプリント配線板	486	11,662	103.6	93.6	3,062	75,103	101.9	91.2
	片面フレキシブル配線板	181	3,362	88.3	81.5	1,214	22,285	90.4	76.6
	両面・多層フレキシブル配線板	305	8,300	115.5	99.5	1,848	52,818	111.4	99.2
	モジュール基板	356	20,058	125.8	105.8	2,245	135,076	117.8	98.5
	リジッド系モジュール基板	66	13,230	129.4	109.8	409	85,979	115.5	97.6
その他のモジュール基板	291	6,828	125.4	98.8	1,836	49,097	118.5	100.1	
その他の電子回路基板	0	41	0.0	25.0	3	433	23.1	39.8	
平成 20年 8月 実績	電子回路基板	1,846	70,722	88.3	89.0	16,266	628,756	98.3	95.3
	リジッドプリント配線板	1,157	43,354	86.3	93.7	10,269	390,776	94.4	96.3
	片面プリント配線板	200	1,159	84.7	96.7	1,692	9,751	86.7	95.4
	両面プリント配線板	506	10,368	86.3	85.4	4,477	92,004	93.2	93.8
	多層プリント配線板(4層)	192	6,787	76.2	86.5	1,876	66,534	95.3	94.1
	多層プリント配線板(6-8層)	110	9,996	93.2	106.3	955	87,856	100.1	99.0
	多層プリント配線板(10層以上)	18	3,240	78.3	84.2	196	32,274	99.5	92.1
	ビルドアップ多層配線板	132	11,804	105.6	99.7	1,074	102,357	107.6	99.4
	フレキシブルプリント配線板	427	10,266	96.6	87.3	3,489	85,369	101.2	90.7
	片面フレキシブル配線板	156	3,132	77.2	76.8	1,370	25,417	88.7	76.6
	両面・多層フレキシブル配線板	271	7,134	112.9	92.8	2,119	59,952	111.6	98.4
	モジュール基板	262	17,065	85.6	80.4	2,507	152,141	113.4	96.0
	リジッド系モジュール基板	54	11,435	91.5	81.7	463	97,414	112.1	95.4
その他のモジュール基板	208	5,630	84.2	77.8	2,044	54,727	113.7	97.2	
その他の電子回路基板	0	37	0.0	21.3	3	470	20.0	37.2	

電子回路基板生産動向(2008年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 20年 9月 実績	電子回路基板	2,083	83,742	98.5	105.2	18,349	712,498	98.3	96.4
	リジッドプリント配線板	1,323	52,447	95.4	107.1	11,592	443,223	94.5	97.5
	片面プリント配線板	223	1,293	91.0	100.0	1,915	11,044	87.2	96.0
	両面プリント配線板	567	11,593	93.4	90.1	5,044	103,597	93.2	93.4
	多層プリント配線板(4層)	221	8,456	83.4	97.2	2,097	74,990	93.9	94.5
	多層プリント配線板(6-8層)	127	11,886	100.0	119.7	1,082	99,742	100.1	101.1
	多層プリント配線板(10層以上)	22	4,472	95.7	107.9	218	36,746	99.1	93.8
	ビルドアップ多層配線板	163	14,747	137.0	122.4	1,237	117,104	110.7	101.8
	フレキシブルプリント配線板	489	11,789	109.9	104.1	3,978	97,158	102.2	92.2
	片面フレキシブル配線板	156	3,091	75.7	75.9	1,526	28,508	87.2	76.6
	両面・多層フレキシブル配線板	333	8,698	139.3	119.9	2,452	68,650	114.7	100.7
	モジュール基板	271	19,474	96.4	101.8	2,778	171,615	111.5	96.7
	リジッド系モジュール基板	65	13,962	122.6	112.8	528	111,376	113.3	97.3
その他のモジュール基板	206	5,512	90.4	81.6	2,250	60,239	111.1	95.5	
その他の電子回路基板	0	32	0.0	16.8	3	502	17.6	34.6	
平成 20年 10月 実績	電子回路基板	2,034	77,929	88.8	85.0	20,383	790,427	97.3	95.1
	リジッドプリント配線板	1,305	47,838	85.7	82.2	12,897	491,061	93.6	95.7
	片面プリント配線板	226	1,338	84.0	95.5	2,141	12,382	86.8	95.9
	両面プリント配線板	556	11,058	85.4	84.1	5,600	114,655	92.3	92.4
	多層プリント配線板(4層)	221	7,412	75.9	67.2	2,318	82,402	91.8	91.1
	多層プリント配線板(6-8層)	121	10,178	81.8	72.3	1,203	109,920	97.9	97.5
	多層プリント配線板(10層以上)	20	3,852	76.9	81.1	238	40,598	96.7	92.4
	ビルドアップ多層配線板	161	14,000	115.8	101.8	1,398	131,104	111.3	101.8
	フレキシブルプリント配線板	491	11,789	102.7	96.0	4,469	108,947	102.3	92.6
	片面フレキシブル配線板	159	3,052	76.4	75.0	1,685	31,560	86.0	76.4
	両面・多層フレキシブル配線板	332	8,737	123.0	106.4	2,784	77,387	115.6	101.3
	モジュール基板	237	18,237	82.6	86.6	3,015	189,852	108.5	95.6
	リジッド系モジュール基板	65	13,256	108.3	94.4	593	124,632	112.7	97.0
その他のモジュール基板	172	4,981	76.1	71.1	2,422	65,220	107.6	93.1	
その他の電子回路基板	0	65	0.0	31.1	3	567	15.0	34.1	
平成 20年 11月 実績	電子回路基板	1,664	60,639	72.8	68.7	22,047	851,066	94.9	92.6
	リジッドプリント配線板	1,104	38,393	73.6	68.4	14,001	529,454	91.6	93.0
	片面プリント配線板	199	1,180	80.6	87.0	2,340	13,562	86.3	95.1
	両面プリント配線板	480	9,431	72.3	71.0	6,080	124,086	90.4	90.3
	多層プリント配線板(4層)	198	6,365	68.8	64.1	2,516	88,767	89.5	88.5
	多層プリント配線板(6-8層)	87	7,624	64.4	60.2	1,290	117,544	94.6	93.7
	多層プリント配線板(10層以上)	16	3,165	59.3	65.6	254	43,763	93.0	89.8
	ビルドアップ多層配線板	125	10,628	89.9	75.6	1,523	141,732	109.2	99.2
	フレキシブルプリント配線板	371	8,995	75.7	75.5	4,840	117,942	99.6	91.0
	片面フレキシブル配線板	114	2,324	55.6	64.4	1,799	33,884	83.1	75.4
	両面・多層フレキシブル配線板	257	6,671	90.2	80.3	3,041	84,058	112.9	99.2
	モジュール基板	189	13,192	64.1	66.0	3,204	203,044	104.2	92.9
	リジッド系モジュール基板	50	9,447	82.0	71.9	643	134,079	109.5	94.6
その他のモジュール基板	139	3,745	59.7	54.8	2,561	68,965	103.1	89.7	
その他の電子回路基板	0	59	0.0	29.5	3	626	13.6	33.6	
平成 20年 12月 実績	電子回路基板	1,319	44,378	62.6	53.3	23,366	895,444	92.2	89.3
	リジッドプリント配線板	901	29,334	66.2	54.4	14,902	558,788	89.5	89.7
	片面プリント配線板	178	895	79.8	69.9	2,518	14,457	85.8	93.0
	両面プリント配線板	382	7,407	63.7	59.2	6,462	131,493	88.2	87.7
	多層プリント配線板(4層)	154	5,109	59.5	53.7	2,670	93,876	86.9	85.4
	多層プリント配線板(6-8層)	80	6,553	62.5	52.7	1,370	124,097	91.8	90.0
	多層プリント配線板(10層以上)	13	2,363	50.0	51.2	267	46,126	89.3	86.4
	ビルドアップ多層配線板	94	7,007	75.2	51.7	1,617	148,739	106.4	95.1
	フレキシブルプリント配線板	275	6,719	61.8	58.7	5,115	124,661	96.4	88.4
	片面フレキシブル配線板	80	1,758	41.5	47.6	1,879	35,642	79.7	73.3
	両面・多層フレキシブル配線板	195	4,961	77.4	64.1	3,236	89,019	109.9	96.3
	モジュール基板	143	8,256	48.0	46.4	3,347	211,300	99.3	89.4
	リジッド系モジュール基板	35	5,467	66.0	49.7	678	139,546	105.9	91.4
その他のモジュール基板	108	2,789	44.1	41.2	2,669	71,754	97.8	85.8	
その他の電子回路基板	0	69	0.0	38.1	3	695	12.5	34.0	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2009/02/16 発表 / 2009/02/16 JPCA作成)